

令和4(2022)年度 信州大学大学院総合理工学研究科
「超微細加工技術」社会人スキルアップコース

材料・塑性加工プログラム

募集要項

1. 人材養成目的

新製品開発や技術革新など、地域経済の活性化に寄与するため、地元自治体との連携により、精密加工・製造分野での技術革新を担う人材を創出することを目的とする。

2. 募集について

1) 募集人員

5名

2) 受講のための資格・要件

以下の①~④のすべてを満たす必要があります。

①精密加工に関する産業、またはそれに関連した産業に従事している者

②昼間、夜間、および土曜日の受講が可能な者

③企業にあっては、上司の承諾が得られること

④大学を卒業した方、または、本コースにおいて個別の受講資格審査により大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた方で、令和4年3月31日までに22歳に達する者

(※様式5 受講資格審査申請書が必要)

3) 受講料

5万円(教材費含む。受講決定後に納付通知書をお送りします。)

4) 出願手続き

①出願期間

令和4(2022)年1月5日(水)~1月21日(金)

②出願方法

・郵送 … 「5 出願書類の提出先」に郵便(1月21日(金)消印有効)

・持参 … 「5 出願書類の提出先」に持参(事前連絡のうえお持ちください)

③出願書類等

・様式1 受講志願票

・様式2 履歴書

・様式3 受講希望理由書

・様式4 受講承諾書(勤務先の責任者の承諾書が必要です。)

・様式5 受講資格審査申請書

大学を卒業した方や、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧大学評価・学位授与機構)により学士の学位を授与された方以外の方は、受講資格審査申請書を提出し、受講資格を認められた場合に限り受講することができます。現在までの学習歴、活動歴、実務経験歴等(以下「学習歴等」という)について、具体的に自由形式で記述したものを提出してください。なお、学習歴等については、次の①から④までのような事項が考えられます。

①短期大学、高等専門学校等における学習歴

②研究機関、教育機関、企業等における実務経験等

③海外における国際団体等での活躍経験及びそれを通じて一定の語学力を有している等

④コンピュータ・ソフトウェアの制作等の実務経験等

5) 出願書類の提出先

〒394-0028 長野県岡谷市本町1丁目1-1

テクノプラザおかや2階 信州大学諏訪圏サテライトキャンパス

※出願上の留意点※

- ・申請書類を郵送する場合は様式6に記載のとおり、履歴の残る（追跡できる）「簡易書留」「レターパック」等で提出してください。
- ・サテライトキャンパスへ持参する場合は、事前に連絡のうえお越してください。
- ・申請書類に不備のあったものは受け付けられませんので、記載には十分ご注意ください。
- ・虚偽の記載があったものは、受講許可を取り消す場合があります。

6) 選考方法

受験者の選考は、提出された書類をもとに行います。

これまでの自分のキャリア、本コースに入りたいこと、およびコース修了後にどのように活かせるかなどが分かるよう記入してください。

7) 発表

令和4(2022)年2月22日(火)に本人に通知(郵送)します。

3. 受講科目

- ・先端材料学特論
- ・超精密塑性加工学特論

4. 修了要件

- ・指定科目を60時間受講して認定を受けること。
- ・認定は、科目毎にレポート又は試験を課して成績を評価します。
- ・修了者には信州大学長名の履修証明書を授与します。

5. その他

- ・本プログラムは、西暦末尾偶数年度に開講する隔年開講のプログラムです。
- ・西暦末尾奇数年度は、「位置決め・切削加工プログラム」(精密位置決め技術特論、超精密切削加工学特論)を開講予定です。
- ・本プロジェクトには、受講・実習のための交通費の支給・宿泊施設の提供はありません。
- ・飯田サテライトキャンパス開講の「電気機器関連制御技術」社会人スキルアップコース「制御技術プログラム」と並行して受講することも可能です(別途出願が必要)。
- ・実施方法について、受講生の皆様のご要望に応じて、サテライトキャンパスでの対面授業、オンライン授業、または対面とオンラインの併用での授業対応を予定しております。

6. 問い合わせ先

本件に関する不明な点等ありましたら、以下までお問い合わせください。

信州大学諏訪圏サテライトキャンパス事務室

コーディネーター 渡邊 淳、小林敦仁

〒394-0028 長野県岡谷市本町1丁目1-1 テクノプラザおかや2階

TEL : 0266-21-1561 090-5759-8102 (携帯)

Fax : 0266-21-1565 E-mail: junwatanabe@shinshu-u.ac.jp